



【346A】

NF・米国株S&P500半導体ETF

NEXT FUNDS S & P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指連動型上場投信【正式名称】



- S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指連動型上場投信(上場投資信託)です。

1.概要

(2025年6月30日 現在)

銘柄名	NEXT FUNDS S & P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指連動型上場投信		
対象指標	S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指連動型上場投信(上場投資信託)		
計算期間	毎年9月11日から翌年9月10日		
分配金支払基準日	毎年9月10日(年1回)		
管理会社	野村アセットマネジメント	NISA制度成長投資枠	対象
銘柄コード	346A	市場価格(終値)(※1)	2,460.0 円
売買単位	1口単位	1口あたり分配金(※2)	0円
信託報酬(税込)	0.352%	分配金利回り(※3)	0.00%
純資産総額	6 億円	東証マーケットメイク制度(※4)	対象
受益権口数	250,000 口	1売買単位あたりの投資金額(※1)	2,460 円

※1 上記の期日において約定がない場合、「市場価格(終値)」及び「1売買単位あたりの投資金額」には、直近時点の市場価格を記載しています。

※2 直近12か月の実績分配金を記載しています。

※3 直近12か月の実績分配金及び作成日の終値をもとに算出した分配金利回りを記載しています。

※4 東証が2018年7月2日に導入したETF市場におけるマーケットメイク制度の対象銘柄か否かを記載しています。マーケットメイクとはマーケットメイカーが気配を提示して取引の流動性を提供することです。

2.パフォーマンス

(2025年6月30日 現在)



■騰落率

期間	当銘柄	(参考)TOPIX
過去3か月	+30.64%	+3.47%
過去6か月	-	+2.44%
過去1年	-	+1.54%
過去3年	-	+52.49%
過去5年	-	+83.02%

※ 2025年3月27日 の市場価格を基準値とし、TOPIXの値を再換算しています。

3.ファンド組入銘柄

(2025年5月30日 現在)

	証券コード	銘柄名	構成比
1	NVDA	NVIDIA CORP	34.66%
2	AVGO	BROADCOM INC	27.80%
3	AMD	ADVANCED MICRO DEVICES	4.49%
4	TXN	TEXAS INSTRUMENTS INC	4.13%
5	QCOM	QUALCOMM INC	4.02%

4.情報ベンダーコード

情報ベンダー名	ETFコード	対象指標
QUICK	346A/T	-
Bloomberg	346A JP Equity	SPXSSCUT
Refinitiv	346A.T	-

5.対象指標の概要

S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指連動型上場投信(上場投資信託)は、S&P 500 半導体・半導体装置(産業グループ)指数の構成銘柄のパフォーマンスを測定します。また、指標は、フロート調整後の時価総額加重方式を採用しており、1社あたりの比重は指標全体の35%を上限としています。